
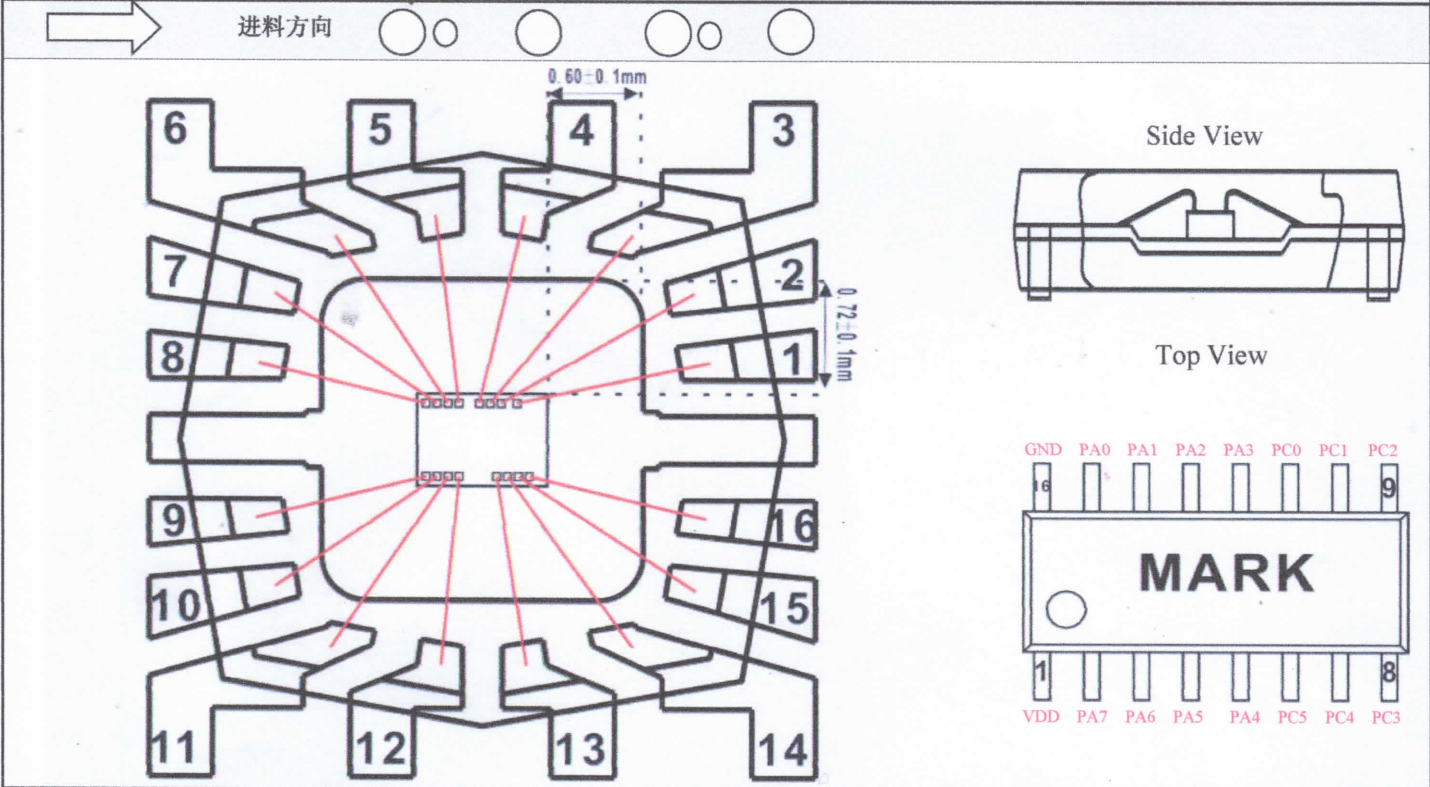
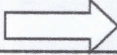
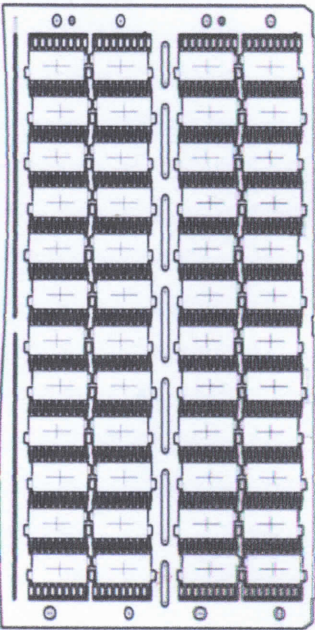


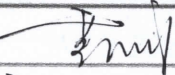
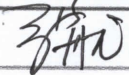
<div> <b>山东汉芯科技有限公司</b> ShanDong HanXin Technology Co., Ltd TEL:0632-7528601 FAX:0632-7528604</div>		文件编号	BD-HXQ73-SOP16005				
		文件名称	SOP16L 焊线图				
芯片型号	HS6002	产品名称	HS16P2811	客户代码	HXQ73	版本	A

版本信息:

版本	修改内容	修改日期	修改人
A	初版发行	2024-11-07	卢圣琼



 进料方向																							
<table><tr><th>项目</th><th>参数信息</th></tr><tr><td>划片道宽度</td><td>60um</td></tr><tr><td>框架规格</td><td>80*80mil<sup>2</sup></td></tr><tr><td>粘胶型号</td><td>导电胶</td></tr><tr><td>芯片尺寸</td><td>835*590um<sup>2</sup> (不含划片道)</td></tr><tr><td>芯片厚度</td><td>260±10um</td></tr><tr><td>焊点尺寸</td><td>49*49um<sup>2</sup></td></tr><tr><td>焊点间距</td><td>NA</td></tr><tr><td>焊线根数</td><td>16 根</td></tr><tr><td>焊线总长</td><td>NA</td></tr><tr><td>焊线线径</td><td>合金线/20um</td></tr></table>	项目	参数信息	划片道宽度	60um	框架规格	80*80mil <sup>2</sup>	粘胶型号	导电胶	芯片尺寸	835*590um <sup>2</sup> (不含划片道)	芯片厚度	260±10um	焊点尺寸	49*49um <sup>2</sup>	焊点间距	NA	焊线根数	16 根	焊线总长	NA	焊线线径	合金线/20um	<div></div> <div><p>备注:</p><p>PAD(焊盘)铝层厚度: 1.2um</p><p>PAD 下方是否有敏感器件?</p><p>√有      无</p><p>客户注意:</p><p>焊接时, PAD 下方或附近有敏感器件时, 压焊会影响成品率和可靠性。</p><p><input type="checkbox"/> 试产    <input type="checkbox"/> 直接量产 (直接量产 我司不予保证良率)</p><p>客户确认签字:</p></div>
项目	参数信息																						
划片道宽度	60um																						
框架规格	80*80mil <sup>2</sup>																						
粘胶型号	导电胶																						
芯片尺寸	835*590um <sup>2</sup> (不含划片道)																						
芯片厚度	260±10um																						
焊点尺寸	49*49um <sup>2</sup>																						
焊点间距	NA																						
焊线根数	16 根																						
焊线总长	NA																						
焊线线径	合金线/20um																						

制定	卢圣琼	审核		批准	
制定日期	2024-11-07	审核日期	2024.11.08	批准日期	2024.11.08